

SMT 256BC浸漬黏合劑產品資料表

增強焊點可靠性

免除底部填充膠

高良率

簡介

SMT 256BC 焊點封裝膠旨在提高焊點可靠性，並消除 CSP、BGA、倒裝晶片和 PoP (封裝堆疊) 封裝的焊點開裂問題，特別適用於無鉛焊接應用。在回流焊過程中，SMT 256BC 可去除金屬氧化物，使焊點得以形成；同時，三維聚合物網絡開始形成，並封裝單一焊點，從而增強焊點強度，消除底部填充的一些缺點 (例如高於玻璃化轉變溫度 (Tg) 的高熱膨脹係數、製程控制困難等)。與使用助焊劑或焊膏相比，SMT 256BC 可顯著提高焊點的可靠性，例如熱循環性能和跌落性能。此聚合物網絡可以使用丁酮 (MEK) 或加熱來去除。

物理特性

产品名称	SMT 256BC 浸漬型胶水
外观	黑色液体
未固化材料性能	
项目	数值
比重 (ASTM D1475-60)	1.05
粘度 (Brookfield, 0.5 rpm)	8,000-10,000 cp
定量卤化物含量	0%
提取离子(MIL-STD-883E)	
Na+	<5ppm
K+	<5ppm
F-	<5ppm
Cl-	<10ppm

表面绝缘电阻 (J-STD-004)

通过 (Pass)

應用

SMT 256BC 可採用浸塗、點膠、印刷(模板或網版印刷)或接腳轉印等製程進行塗覆。SMT 256BC 用量過少會導致焊點空洞或焊點開路;用量過多則會導致焊錫橋接或焊料溢出。為了獲得高效益和最佳可靠性,必須優化 SMT 256BC 的塗覆製程參數。

印刷焊膏, 用於 其他SMT元件 ->將 CSP/BGA/FC 浸入 SMT 256BC 薄膜中 -> 放置SMT元件 -> 焊料回流, 黏合劑固化

回流焊接和固化

SMT 256BC 與目前的SMT組裝流程以及各種焊盤表面處理(例如Ni/Au、浸銀、OSP)完全相容。它可在空氣或氮氣環境下, 用於對流、傳導、紅外線或氣相焊接系統。從室溫到峰值溫度的時間應為4至5分鐘, 峰值溫度範圍為230°C至260°C

儲存和保存期限

如果將材料保存在低於 -20°C 的密封原包裝容器中, 保存期限為 6 個月。超過此期限儲存可能會導致黏度升高。請防潮、防蒸發、防雜質污染。蒸發和污染會嚴重影響這些產品的加工性能。

安全信息

SMT 256BC 是一種環保無毒材料, 我們建議採用普通生產防護方法處理該產品。詳情請查閱我們的產品安全數據表。

包裝規格

SMT 256BC 系列浸漬膠黏劑有以下型號可供選擇 5 cc, 10 cc 和 30 cc 三種包裝規格, 也可根據客戶要求提供其他包裝方式。請聯系英凱公司了解更多訂購信息。